

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司\*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号：0981)

中芯截至二零零六年六月三十日止三个月业绩公布

国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司（纽约交易所：SMI；香港联交所：981）〔中芯〕或〔本公司〕于今日公布截至二零零六年六月三十日止三个月的综合经营业绩。二零零六年第二季销售额由上一季度的 351,100,000 元上升 2.9%至 361,400,000 元。本公司的月产能增至 167,251 片 8 吋等值晶圆，二零零六年第二季的使用率为 93.5%。二零零六年第二季的毛利率为 13.6%，二零零六年第一季的毛利率为 12.4%。与二零零六年第一季净亏损 8,700,000 元相比，二零零六年第二季为净收入 2,200,000 元。本公司于二零零六年第二季认列了一笔金额为 18,900,000 元的所得税利益，此乃根据美国公认会计原则财务会计准则第 09 号（所得税会计），进行税务规划策略之结果。

- 以下为本公司于二零零六年七月二十八日就截至二零零六年六月三十日止三个月的未经审核业绩在美国报章所作的报章公布全文。
- 本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1)条规定的披露责任于二零零六年七月二十八日作出本公布。

以下为本公司于二零零六年七月二十八日就截至二零零六年六月三十日止三个月的未经审核业绩在美国报章所作的报章公布全文。

所有货币数字主要以美元列账，除非特别指明。

报告内的财务报表数额按美国公认会计原则厘定。

## 概要

- 二零零六年第二季的销售额与二零零六年第一季相比上升 2.9%至 361,400,000 元，与二零零五年第二季相比上升 29.3%。
- 毛利率由二零零六年第一季的 12.4%升至二零零六年第二季 13.6%
- 二零零六年第二季的净收入为 2,200,000 元，而二零零六年第一季为净亏损 8,700,000 元以及二零零五年第二季为净亏损 40,400,000 元

中国上海—二零零六年七月二十八日—国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司（纽约交易所：SMI；香港联交所：981）（「中芯」或「本公司」）于今日公布截至二零零六年六月三十日止三个月的综合经营业绩。二零零六年第二季销售额由上一季度的 351,100,000 元上升 2.9%至 361,400,000 元。本公司的月产能增至 67,251 片 8 吋等值晶圆，二零零六年第二季的使用率为 93.5%。与二零零六年第一季 12.4%的毛利率相比，二零零六年第二季的毛利率为 13.6%。与二零零六年第一季的净亏损 8,700,000 元相比，二零零六年第二季为净收入 2,200,000 元。本公司于二零零六年第二季确认了一笔金额为 18,900,000 元的所得税利益，此乃根据美国公认会计原则财务会计准则第 109 号（所得税会计），进行税务规划策略之结果。

“由于我们在 0.13 微米及更先进工艺技术上获得的营收占第二季总营收的 47.5%，我们将不断增进核心代工的能力”，中芯国际总裁张汝京博士说，“从 0.13 微米逻辑产品获得的营收占了我们逻辑产品营收的 22.5%，比起第一季的 13.3% 有显著增加。我们预期这个趋势会持续，因为更多我们的客户订单转移到 0.13 微米和 90 奈米逻辑制程。

我们北京 12 吋厂已在第二季成功获得 90 奈米认证并开始生产我们第一个 90 奈米逻辑产品；同时，北京 12 吋厂也成功以 90 奈米制程获得尔必达的 512M-bit DDR2 SDRAM 认证。

我们在此很高兴的向大家报告 Saifun 的 90 奈米 NROM Flash 已试产成功，现已产出第一批工程样品，这意味着此产品将在二零零六年第四季开始成功量产。

由于一些客户因进行存量调整而减少订单，我们对 2006 年下半年持审慎乐观的评估。然而，中国市场弥补了这些订单延期的损失。由于 SMIC 贴近中国终端客户的在地优势 我们看到来自中国大陆的客户和很多全球半导体公司选择与 SMIC 合作，共同打开在中国的市场。我们乐见中国客户的发展 并期望从这些客户获得的营收比例会持续增加。另外，我们正观察全球的半导体公司选择与中芯合作以取得接近中国客户优势的趋势。

当我们继续执行经营计划的同时，也为将来在半导体产业发展谨慎铺设基础，并以审慎的态度拓展我们的事业。”

电话会议 / 网上业绩公布详情

日期：二零零六年七月二十八日

时间：上海时间上午八时正

拨号及登入密码：美国 1-617-597-5342（密码：SMIC）或香港 852-3002-1672（密码：SMIC）。

二零零六年第二季业绩公布网上直播可于 [www.smics.com](http://www.smics.com) 网站「投资者关系」一栏收听。中芯网站在网上广播后为期十二个月提供网上广播录音版本连同本新闻发布的软拷贝。

#### 关于中芯国际

中芯国际 (纽约证券交易所: SMI, 香港联合交易所: 0981)总部位于上海,是世界领先的集成电路芯片代工公司之一,也是中国内地最大及最先进的芯片代工公司。向全世界客户提供0.35微米到90纳米及更先进工艺的芯片制造服务。公司在上海营运三座8英寸芯片厂,在天津营运一座8英寸芯片厂,并在北京营运一座12英寸芯片厂,此为内地第一座正式营运之12英寸芯片厂。此外,中芯国际还在美国、意大利、日本提供客户服务和设立销售办事处,同时在香港设立了代表处。敬请访问公司网站: <http://www.smics.com>

#### 安全港声明

(根据1995私人有价证券诉讼改革法案)

本次新闻发布可能载有(除历史资料外)依据1995年美国私人有价证券诉讼改革法案的“安全港”条文所界定的「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述,包括关于中芯预期来自0.13微米及以下技术晶圆的销售额占总销售额的百分比以及来自中国大陆客户的销售比例将持续增长的声明、关于全球半导体公司选择与中芯国际合作的趋势的声明、关于本公司采用何种方式执行经营计划和发展业务的声明以及在随后“资本开支概要”和“二零零六年第三季度指引”中的声明乃根据中芯对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯使用「相信」、「预期」、「计划」、「估计」、「预计」、「预测」及类似表述为该等前瞻性陈述之标识,尽管并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。

该等前瞻性陈述乃反映中芯高级管理层根据最佳判断作出的估计,存在重大已知及未知风险、不确定性,以及其它可能导致中芯实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素,包括(但不限于)与半导体行业周期及市场状况有关的风险、激烈竞争、中芯客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造生产量供给及最终市场的金融局势是否稳定。

投资者应考虑中芯呈交予美国证券交易委员会(「证交会」)的文件资料,包括其于二零零五年六月二十九日以20-F表格形式呈交予证交会的经修订的年度报告,特别是「风险因素」及「有关财务状况及经营业绩的管理层讨论及分析」两个部份,以及其于二零零四年三月八日以A-1表格形式呈交予香港联合交易所(「香港联交所」)的登记声明,以及中芯可能不时向证交会及香港联交所呈交的该等其它文件,包括6-K表格。其它未知或不可预知的因素亦可能会对中芯日后的业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于上述风险、不确定性、假设及因素,本新闻发布中提及的前瞻性事件可能不会发生。务请阁下注意,切勿过份依赖此等前瞻性陈述,此等陈述仅就本新闻发布中所载述日期(或如无有关日期,则为本新闻发布日期)的情况而表述。

除法律有所规定以外，中芯概不就因新资料、未来事件或其它原因引起的任何情况承担任何责任，亦不拟更新任何前瞻性陈述。

投资者联络资料：

Calvin Lau

电话：+86-21-5080-2000，内线：16693

[Calvin\\_Lau@smics.com](mailto:Calvin_Lau@smics.com)

手机：+852-9435-2603

手机：+86-13636468590

Douglas Hsiung

电话：+86-21-5080-2000，内线：12804

[Douglas\\_hsiung@smics.com](mailto:Douglas_hsiung@smics.com)

手机：+86-13795272240

二零零六年第二季经营业绩概要：

以千美元为单位（每股盈利和百分比除外）

	<u>二零零六年 第二季度</u>	<u>二零零六年 第一季度</u>	<u>季度比较</u>	<u>二零零五年 第二季度</u>	<u>年度比较</u>
销售收入	361,446	351,138	2.9%	279,500	29.3%
销售成本	312,229	307,768	1.4%	273,111	14.3%
毛利	49,217	43,370	13.5%	6,389	670.4%
经营开支	56,141	49,335	13.8%	38,469	45.9%
经营亏损	(6,924)	(5,965)	16.1%	(32,081)	-78.4%
其它收入（支出）	(9,491)	(7,807)	21.6%	(8,234)	15.3%
所得税利益（费用）	18,892	(14)	-	(118)	-
税后净收入（亏损）	2,476	(13,786)	-	(40,433)	-
少数股权	767	947	-19.0%	(12)	-
应占联营公司亏损	(1,002)	(1,058)	-5.3%	-	-
会计准则改变的累计影响	-	5,154	-	-	-
普通股持有人应占收入（亏损）	2,242	(8,743)	-	(40,445)	-
毛利率	13.6%	12.4%		2.3%	
经营利润率	-1.9%	-1.7%		-11.5%	
每股普通股份净收入（亏损）—基本(1)	\$0.0001	(\$0.0005)		(\$0.0022)	
每股美国预托股份净收入（亏损）—基本	\$0.0061	(\$0.0239)		(\$0.1113)	
每股普通股份净收入（亏损）—摊薄(1)	\$0.0001	(\$0.0005)		(\$0.0022)	
每股美国预托股份净收入（亏损）—摊薄	\$0.0060	(\$0.0239)		(\$0.1113)	

付运晶圆（8吋等值）(2)	388,498	388,010	0.1%	330,499	17.5%
逻辑平均售价(3)	\$979	\$945	3.6%	\$938	4.4%
综合平均售价	\$888	\$862	3.0%	\$807	10.0%
简化平均售价(4)	\$930	\$905	2.8%	\$846	9.9%
产能使用率	93.5%	94.9%		86.5%	

附注：

(1) 基于二零零六年第二季加权平均普通股 18,303,000,000 股（基本）及 18,729,000,000 股（摊薄），二零零六年第一季 18,278,000,000 股（基本/摊薄），二零零五年第二季 8,169,000,000 股（基本/摊薄）。

(2) 包括铜接连件

(3) 不包括铜接连件

(4) 销售总额/晶圆付运总数

- 二零零六年第二季销售额升至 361,400,000 元，较二零零六年第一季的 351,100,000 元录得季度升幅 2.9%，并较二零零五年第二季的 279,500,000 元录得年度升幅 29.3%，此上升主要由于综合平均售价季度增幅为 3.0%。
- 销售成本从二零零六年第一季的 307,800,000 元上升 1.4% 至二零零六年第二季的 312,200,000 元，主要由于产品组合优化。
- 二零零六年第二季毛利上升至 49,200,000 元，较二零零六年第一季的 43,400,000 元录得季度升幅 13.5%；较二零零五年第二季的 6,400,000 元录得年度升幅 670.4%
- 毛利率从二零零六年第一季的 12.4% 上升至二零零六年第二季 13.6% 主要是由于产品组合优化所致。
- 二零零六年第二季的经营开支为 56,100,000 元，与二零零六年第一季的 49,300,000 元相比上升 13.8%。
- 经营亏损从二零零六年第一季的 6,000,000 元上升 16.1% 至二零零六年第二季的 6,900,000 元。
- 其它非经营性亏损由二零零六年第一季的 7,800,000 元上升 21.6% 至二零零六年第二季的 9,500,000 元，主要是由于二零零六年第二季的汇兑净亏损为 2,000,000 元。
- 二零零六年第二季的汇兑净亏损为 6,800,000 元。
- 二零零六年第二季的净收入为 2,200,000 元，而二零零六年第一季为净亏损 8,700,000 元及二零零五年第二季为净亏损 40,400,000 元。
- 由于在二零零六年第二季税务规划策略开始生效，部分资产的税务认定金额和入帐金额之间产生暂时性差异。基于财务会计准则第 109 号，本公司认列了一笔金额为 8,900,000 元所得税利益。

## 1. 收入分析

销售分析

以应用分类	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季
计算机	30.6%	36.0%	34.8%	33.7%	39.8%
通讯	46.2%	45.8%	43.8%	39.8%	40.4%
消费	18.6%	13.3%	16.6%	22.8%	15.2%
其它	4.6%	4.9%	4.8%	3.7%	4.6%
以装置分类	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季
逻辑（包括铜接连线）	66.6%	62.8%	65.3%	65.5%	58.9%
记忆 (1)	28.8%	32.4%	31.3%	31.0%	36.5%
其它（光罩制造及探测等）	4.6%	4.8%	3.4%	3.5%	4.6%
以客户类别分类	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季
非厂房半导体公司	49.8%	41.8%	43.2%	43.2%	42.2%
集成装置制造商	41.9%	52.8%	51.7%	52.8%	55.2%
系统公司及其它	8.3%	5.4%	5.1%	4.0%	2.6%
以地区分类	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季
北美洲	46.7%	43.5%	39.2%	42.9%	40.8%
亚太区（不包括日本）	20.9%	21.3%	28.2%	25.7%	26.3%
日本	4.9%	3.3%	3.6%	4.5%	6.0%
欧洲	27.5%	31.9%	29.0%	26.9%	26.9%
<b>晶圆收入分析</b>					
各技术占晶圆销售额的百分比 （仅包括逻辑、记忆及铜接连线）	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季
0.13 微米及以下	47.5%	46.6%	42.9%	43.8%	44.5%
0.15 微米	4.7%	8.7%	5.2%	2.7%	2.5%
0.18 微米	38.0%	35.7%	42.3%	45.3%	40.7%
0.25 微米	2.0%	1.6%	3.3%	3.1%	3.9%
0.35 微米	7.8%	7.4%	6.3%	5.1%	8.4%
各逻辑技术占逻辑晶圆销售额百分比 (1)	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季
0.13 微米及以下 (2)	22.5%	13.3%	10.9%	14.7%	12.6%
0.15 微米	7.2%	14.5%	8.6%	5.3%	4.8%
0.18 微米	55.8%	57.7%	65.3%	67.4%	59.4%
0.25 微米	2.5%	2.3%	4.8%	4.0%	7.1%
0.35 微米	12.0%	12.2%	10.4%	8.6%	16.1%

附注：

- (1) 不包括 0.13 微米铜接连线
- (2) 代表来自于全流程制造晶圆的销售收入

- 与二零零六年第一季相比，二零零六年第二季应用于消费类产品的芯片的销售增长速度快于其它应用领域。

- 二零零六年第二季逻辑晶圆（包括铜接连件）的销售额占总销售额的百分比与二零零六年第一季度的 62.8%及二零零五年第二季的 58.9% 相比，上升至 66.6%。
  - 二零零六年第二季源自北美及日本客户的销售额占总销售额的百分比与二零零六年第一季度的 43.5%及 3.3% 相比，上升至 46.7%及 4.9%。
  - 二零零六年第二季 0.13 微米及以下技术晶圆的销售额占晶圆销售额百分比与二零零六年第一季度的 46.6%及二零零五年第二季度的 44.5%相比上升至 47.5%。
  - 二零零六年第二季 0.13 微米及以下技术逻辑晶圆的销售额占逻辑晶圆销售额的百分比与二零零六年第一季度的 13.3%及二零零五年第二季度的 12.6%相比上升至 22.5%。
- **产能:**

厂 / (晶圆尺寸)	二零零六年第二季 <sup>(1)</sup>	二零零六年第一季 <sup>(1)</sup>
一厂 (8 吋)	43,000	43,000
二厂 (8 吋)	49,034	47,954
四厂 (12 吋)	35,438	30,220
七厂 (8 吋)	17,216	15,000
每月晶圆装配总产能	144,688	136,174
<b>铜接连件:</b>		
三厂 (8 吋)	22,563	21,156
每月铜接连件总产能	22,563	21,156

附注:

(1) 期终每月晶圆计 8 吋等值

- 截至二零零六年第二季度末，每月产能增加至 167,251 片 8 吋等值晶圆主要由于北京晶圆四厂和天津晶圆七厂产能扩张。

**付运及使用率:**

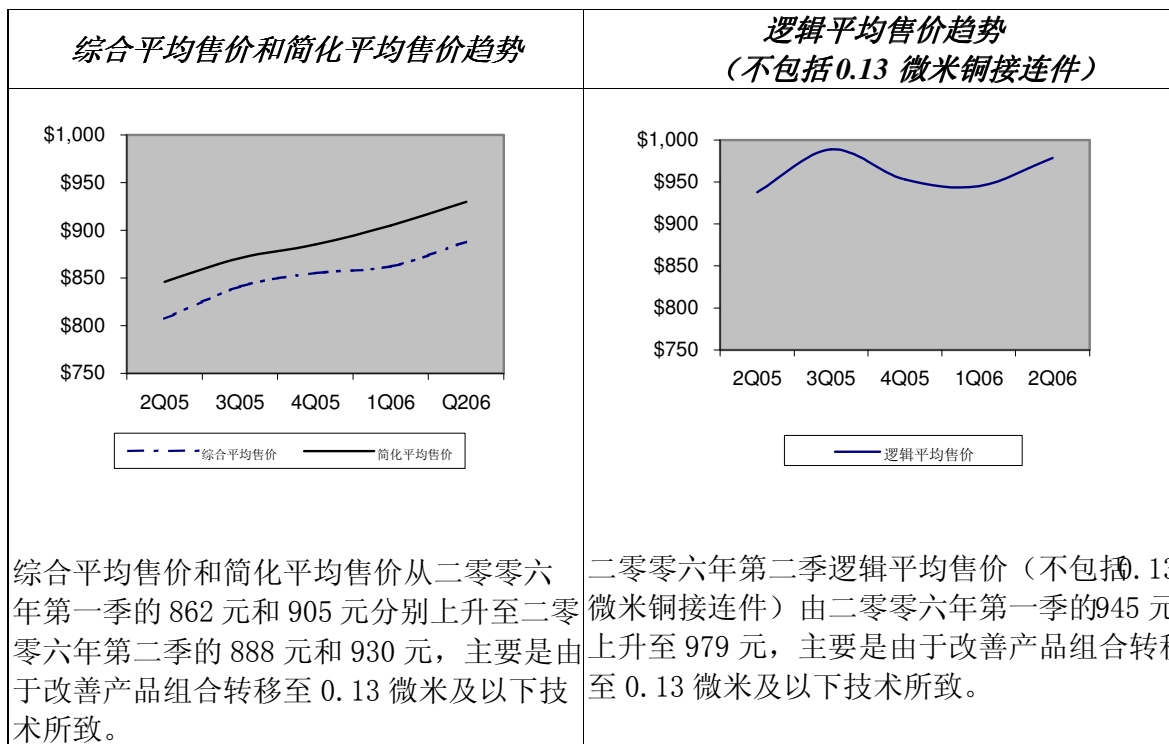
8 吋等值晶圆	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	二零零五年 第四季	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季
付运晶圆 (包括铜接连件)	388,498	388,010	376,227	355,664	330,499
使用率 <sup>(1)</sup>	93.5%	94.9%	93.0%	92.1%	86.5%

附注:

(1) 产能使用率按输出晶圆总额除以估计产能计算

- 二零零六年第二季晶圆付运增加至 388,498 片 8 吋等值晶圆，较二零零六年第一季的 388,010 片 8 吋等值晶圆及二零零五年第二季度的 330,499 片 8 吋等值晶圆分别录得季度升幅 0.1%及年度升幅 17.5%。

- 使用率下降至 93.5%。



## 2. 详细财务分析

### 毛利分析

以千美元计	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	季度比较	二零零五年 第二季	年度比较
销售成本	312,229	307,768	1.4%	273,111	14.3%
折旧	188,663	189,054	-0.2%	171,216	10.2%
其它制造成本	123,566	118,714	4.1%	101,895	21.3%
毛利	49,217	43,370	13.5%	6,389	670.4%
毛利率	13.6%	12.4%		2.3%	

- 销售成本从二零零六年第一季 307,800,000 元增加 1.4% 至二零零六年第二季的 312,200,000 元，主要由于产品组合优化。



- 二零零六年第二季毛利增加至 49,200,000 元，与二零零六年第一季的 43,400,000 元相比录得季度升幅 13.5%，与二零零五年第二季的 6,400,000 元相比录得年度升幅 670.4%。
- 毛利率从二零零六年第一季的 12.4% 上升至二零零六年第二季 13.6%，主要是由于产品组合优化带来较高的综合平均售价所致。

## 经营开支分析

以千美元计	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	季度比较	二零零五年 第二季	年度比较
总经营开支	56,141	49,335	13.8%	38,469	45.9%
研究及开发	24,345	20,593	18.2%	17,590	38.4%
一般及行政	16,837	11,749	43.3%	7,207	133.6%
销售及市场推广	3,918	5,970	-34.4%	3,590	9.2%
无形资产摊销	11,041	11,023	0.2%	10,082	9.5%

- 总经营开支从二零零六年第一季的 49,300,000 元上升至 56,100,000 元，录得季度升幅 13.8%。
- 研发费用从二零零六年第一季的 20,600,000 元上升 18.2% 至二零零六年第二季 24,300,000 元，主要是由于与研发相关的折旧及摊销费用上升以及与上季度相比研发费用补贴减少所致。
- 一般行政费用从二零零六年第一季 11,700,000 元上升 43.3% 至二零零六年第二季 16,800,000 元，主要是由于二零零六年第二季的汇兑损失为 4,800,000 元。
- 销售及市场推广相关费用从二零零六年第一季 6,000,000 元下降 34.4% 至二零零六年第二季 3,900,000 元。主要由于工程材料费用下降所致。
- 取得无形资产摊销指与所获无形资产相关的摊销费用于二零零六年第二季为 11,000,000 元。

## 其它收入（支出）

以千美元计	二零零六年 第二季	二零零六年 第一季	季度比较	二零零五年 第二季	年度比较
其它收入(支出)	(9,491)	(7,807)	21.6%	(8,234)	15.3%
利息收入	4,039	4,595	-12.1%	2,030	99.0%
利息支出	(12,214)	(12,201)	0.1%	(8,971)	36.2%
其它，净额	(1,316)	(201)	555.9%	(1,293)	1.7%

- 二零零六年第二季其它非经营性亏损为 9,500,000 元，相较于二零零六年第一季度的亏损 7,800,000 元上升了 21.6%。主要是由于二零零六年第二季的汇兑净亏损为 2,000,000 元
- 二零零六年第二季的利息支出为 12,200,000 元。

## 流动资金

以千美元计	二零零六年第二季	二零零六年第一季
现金及现金等价物	584,643	485,121
短期投资	3,487	3,525
应收账款	257,248	241,020
存货	217,592	196,585
其它	25,956	16,363
流动资产总计	1,088,926	942,614
应付账款	429,813	286,884
短期借款	118,284	211,608
长期借款的即期部份	47,160	246,081
其它	114,636	119,057
流动负债总计	709,893	863,630
现金比率	0.8x	0.6x
速动比率	1.2x	0.9x
流动比率	1.5x	1.1x

•

## 资本结构

以千美元计	二零零六年第二季	二零零六年第一季
现金及现金等价物	584,643	485,121
短期投资	3,487	3,525
长期票据即期部分	29,242	29,493
长期票据	90,537	104,140
短期借款	118,284	211,608

长期借款的即期部份	47,160	246,081
长期借款	830,743	431,504
总借款	996,187	889,193
现金净额	(527,836)	(534,180)
股东权益	3,028,259	3,019,086
总借款对权益比率	32.9%	29.5%

## 现金流量概要

以千美元计	二零零六年第二季	二零零六年第一季
收入净额	2,242	(8,743)
折旧及摊销	220,242	210,595
购入无形资产摊销	11,041	11,024
现金变动净额	99,523	(100,676)

## 资本开支概要

- 二零零六年第二季资本开支为 317,300,000 元。
- 计划下的二零零六年资本开支总额将约为 1,100,000,000 元，并将根据市场情况作相应调整。

## 二零零六年第三季指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性，部分已于之前的安全港声明中阐明。

- 销售额预期持平或比二零零六年第二季度增长 2%。
- 毛利率预期介于 8%至 12%之间。
- 二零零六年第三季度经营开支相对销售的百分比预期为 15%左右。
- 非经营利息支出预期约介于 15,000,000 元至 17,000,000 元之间。
- 资本开支预期约介于 325,000,000 元至 360,000,000 元之间。
- 折旧及摊销预期约介于 250,000,000 元至 260,000,000 元之间。

## 近期公布

- 中国中部地区第一座 12 英寸厂开工。（二零零六年六月二十八日）
- 中芯国际北京 12 英寸厂生产的 90 奈米 DDR2 SDRAM 成功通过尔必达认证。（二零零六年六月十九日）
- 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司签署了6 亿美元银团贷款。（二零零六年六月八日）
- 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司预计将签署6 亿美元银团贷款。（二零零六年六月七日）
- 董事变更。（二零零六年六月一日）
- 二零零六年五月三十日举行之股东周年常会投票表决结果。（二零零六年六月一日）
- 中芯国际采用 ARM 物理 IP, 支持 90 奈米技术下的低功耗高性能设计。（二零零六年五月三十一日）
- 中芯天津取得扩张所需资金。（二零零六年五月三十一日）
- 智多微电子与中芯国际联合推出阳光二号 C626 手机应用芯片。（二零零六年五月十七日）
- 中芯国际与 Aurora Systems 成功量产数字硅基液面板芯片。（二零零六年五月八日）
- 中芯国际二零零六年第一季业绩报告。（二零零六年四月二十八日）
- 中芯国际和 Cadence 提供新模拟混合信号参考流程用以加速设计公司的芯片设计。（二零零六年四月十三日）

上述公布详情请参阅中芯网站。

[http://www.smics.com/website/enVersion/Press\\_Center/pressRelease.jsp](http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp)

## 合并资产负债表 (美元)

	截至以下日期止	
	二零零六年六月三十日 (未经审核)	二零零六年三月三十一日 (未经审核)
<b>资产</b>		
流动资产:		
现金及现金等价物	584,643,407	485,120,565
短期投资	3,486,997	3,525,210
应收账款, 已扣除拨备 (二零零六年六月三十日为 4,360,447 元, 二零零六年三月三十一日为 3,155,788 元)	257,248,338	241,020,392
存货	217,592,385	196,584,559
预付款项及其它流动资产	20,171,994	16,363,507
待售资产	5,782,422	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,088,925,543</b>	<b>942,614,233</b>
土地使用权, 净额	39,975,613	41,392,218
厂房及设备, 净额	3,378,265,128	3,286,544,385
购入无形资产, 净额	183,230,540	191,933,630
股权投资	15,760,166	16,762,335
长期预付款	4,957,320	2,342,957
递延税款资产	18,892,396	-
<b>资产合计</b>	<b>4,730,006,706</b>	<b>4,481,589,758</b>
<b>负债及股东权益</b>		
流动负债:		
应付帐款	429,813,127	286,884,436
预提费用及其它流动负债	85,373,210	89,469,845
短期借款	118,283,829	211,607,902
长期票据的即期部份	29,242,001	29,492,874
长期借款的即期部份	47,160,000	246,081,155
应付所得税	20,548	93,634
<b>流动负债合计</b>	<b>709,892,715</b>	<b>863,629,846</b>
长期负债:		
长期票据	90,537,615	104,140,277
长期借款	830,742,999	431,504,129
与特许权协议相关的长期应付款	23,507,429	25,395,010
其它长期应付款	10,000,000	-
<b>长期负债合计</b>	<b>954,788,043</b>	<b>561,039,416</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,664,680,758</b>	<b>1,424,669,262</b>
承诺		
少数股权	37,066,848	37,834,500

股东权益：

普通股，面值 0.0004 元，法定股份为 50,000,000,000 股，截止二零零六年六月三十日已发行股份为 18,342,734,332 股，未发行的股份为 18,318,402,283 股。

	7,337,094	7,327,361
认股权证	32,387	32,387
额外缴入股本	3,275,146,135	3,268,265,625
累计其它综合盈余	163,674	122,675
累计亏绌	(254,420,190)	(256,662,052)
	(136,384,949)	
	<b>3,028,259,100</b>	
<b>所有股东权益合计</b>	<b>(29,994,997)</b>	<b>3,019,085,996</b>
	—	
<b>总负债及股东权益合计</b>	<b>4,730,006,706</b>	<b>4,481,589,758</b>

合并营运报表  
(美元)

	截至以下日期止三个月	
	二零零六年六月三十日 (未经审核)	二零零六年三月三十一日 (未经审核)
销售额	361,445,898	351,137,952
销售成本	312,229,121	307,767,802
<b>毛利</b>	<b>49,216,777</b>	<b>43,370,150</b>
经营费用:		
研究和开发	24,344,979	20,592,655
一般管理	16,837,020	11,748,899
销售和市场推广	3,918,343	5,970,146
购入无形资产摊销	11,041,090	11,023,590
<b>经营费用总额</b>	<b>56,141,432</b>	<b>49,335,290</b>
<b>经营亏损</b>	<b>(6,924,655)</b>	<b>(5,965,140)</b>
其它收入(支出):		
利息收入	4,039,328	4,595,384
利息支出	(12,214,076)	(12,201,407)
其它净额	(1,316,005)	(200,656)
<b>其它收入(支出), 净额</b>	<b>(9,490,753)</b>	<b>(7,806,679)</b>
<b>税前净亏损</b>	<b>(16,415,408)</b>	<b>(13,771,819)</b>
所得税利益(费用)	18,891,787	(13,985)
少数股权	767,652	947,364
股权投资亏损	(1,002,169)	(1,058,555)
会计准则改变的累计影响	-	5,153,986
<b>净收入(亏损)</b>	<b>2,241,862</b>	<b>(8,743,009)</b>
视为已派付优先股股息	-	-
<b>普通股持有人应占收入(亏损)额</b>	<b>2,241,862</b>	<b>(8,743,009)</b>
基于每股股份会计调帐前净收入(亏损), 基本	0.0001	(0.0008)
每股股份会计准则改变累计影响金额, 基本	-	0.0003
每股股份净收入(亏损), 基本	0.0001	(0.0005)
基于每股美国预托股份会计调帐前净收入(亏损), 基本	0.0061	(0.0380)

每股美国预托股份会计准则改变累计影响金额，基本	-	0.0141
每股美国预托股份净收入(亏损)，基本	0.0061	(0.0239)
基于每股股份会计调帐前净收入(亏损)，摊薄	0.0001	(0.0008)
每股股份会计准则改变累计影响金额，摊薄	-	0.0003
每股股份净收入(亏损)，摊薄	0.0001	(0.0005)
基于每股美国预托股份会计调帐前净收入(亏损)，摊薄	0.0060	(0.0380)
每股美国预托股份会计准则改变累计影响金额，摊薄	-	0.0141
每股美国预托股份净收入(亏损)，摊薄	0.0060	(0.0239)
用作计算基本每股普通股收入净额的股份(以百万计)	18,303	18,278
用作计算摊薄每股普通股收入净额的股份(以百万计)	18,729	18,278
* 递延股票报酬摊销乃关于：		
销售成本	3,014,597	3,127,678
研究和开发	1,254,569	1,281,330
一般管理	1,227,469	1,211,830
销售和市场推广	509,831	543,929
总计	6,006,465	6,164,767

(1) 每股美国预托股份等于 50 股普通股。



## 合并现金流量表 (美元)

	截至以下日期止三个月	
	二零零六年六月三十日 (未经审核)	二零零六年三月三十一日 (未经审核)
<b>经营活动:</b>		
普通股持有人应占收入(亏损)	2,241,862	(8,743,009)
会计准则改变的累计影响	-	(5,153,986)
净收入(亏损)	2,241,862	(13,896,995)
净收入至经营活动所得(所耗)现金净额对账的调整:		
少数股权	(767,652)	(947,364)
出售厂房及设备的收益(亏损)	(516,812)	1,018
折旧及摊销	220,242,447	210,595,208
购入无形资产摊销	11,041,089	11,023,590
递延股票报酬摊销	6,006,465	6,164,767
贷款前端费用摊销	59,949	-
非现金长期票据利息费用	1,503,505	1,465,312
长期投资亏损	1,002,169	1,058,555
营运资产及负债的变动:		
应收账款	(16,227,946)	313,522
存货	(21,007,826)	(5,346,923)
预付款及其它流动资产	(316,206)	(853,466)
应付账款	(13,274,229)	3,521,334
预提费用及其它流动负债	(11,319,565)	(10,144,265)
其它长期负债	10,000,000	-
应付所得税	(73,086)	93,634
递延税款资产	(18,892,396)	-
<b>经营活动所得现金净额</b>	<b>169,701,768</b>	<b>203,047,927</b>
<b>投资活动:</b>		
购入厂房及设备	(164,934,281)	(197,518,652)
购买所获无形资产	(253,074)	(1,439,000)
出售短期投资	30,704	10,250,212
出售生活园区所得款项	5,631,255	-
处置固定资产所得款项	17,479	1,167,914
<b>投资活动所耗现金净额</b>	<b>(159,507,917)</b>	<b>(187,539,526)</b>
<b>融资活动:</b>		
短期借款所得款项	83,161,736	65,125,158
长期借款所得款项	592,960,001	59,988,601
偿还长期借款支付的款项	(392,642,286)	(123,040,282)
偿还长期票据支付的款项	(15,000,000)	-
偿还短期借款支付的款项	(176,485,809)	(118,998,338)
支付贷款前端费用	(3,596,938)	-
行使雇员购股权所得款项	883,777	736,003

<b>融资活动所得现金净额</b>	<b>89,280,481</b>	<b>(116,188,858)</b>
汇率变动的影晌	48,510	4,135
<b>现金及现金等价物增加(减少)净额</b>	<b>99,522,842</b>	<b>(100,676,322)</b>
<b>现金及现金等价物一期间开始</b>	<b>485,120,565</b>	<b>585,796,887</b>
<b>现金及现金等价物一期间结束</b>	<b>584,643,407</b>	<b>485,120,565</b>

于本公布刊发日期，本公司董事分别有董事会主席兼独立非执行董事王阳元先生、本公司总裁、首席执行官兼执行董事张汝京先生、本公司非执行董事姚方先生，以及本公司独立非执行董事徐大麟先生、川西刚先生、萧崇河先生、陈立武先生、虞有澄先生及江上舟先生。

承董事会命

中芯国际集成电路制造有限公司

首席执行官

张汝京

中国 上海，二零零六年七月二十八日

\* 仅供识别